



**Newsletter No. 6**

**Februar 2021**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 die Individualität elektronischer Baugruppen wird deutlich, wenn man sich die Variabilität von Basismaterialien und Lagenaufbauten anschaut. Die Dokumentation von Leiterplatten gewinnt an Bedeutung. Vielen Dank für Ihr Interesse.  
 Mit freundlichem Gruß,  
 Arnold Wiemers

**Seminar "Leiterplatten 24 ...Chemische Prozesse in der LP-Fertigung"**

Das Verständnis für das CAD-Design und die Fertigung von Leiterplatten ist weitestgehend von mechanischen Eigenschaften geprägt.

Die überwiegende Anzahl der Prozessschritte in der Produktion ist jedoch von chemischen Reaktionen und dem Einsatz chemischer Substrate geprägt. Die Beschichtung der Leiterplattenoberfläche mit einem Metall erfolgt mittels eines chemischen Vorgangs. Das Ätzen der Leiterbildstruktur ist technisch nichts anderes als das Auflösen eines Metalls in einem geeigneten chemischen Reagenz. Leiterplatten werden Säuren und Laugen ausgesetzt. Erdalkali- und Alkalimetalle, Halbmetalle, Nichtmetalle und Edelgase finden sich in Lacken, Loten, Flußmitteln und Vergußmassen ebenso, wie in allen elektronischen Komponenten.

Die physikalischen Eigenschaften von Basismaterialien finden ihren Ursprung in der chemischen Zusammensetzung des Dielektrikums.

Die Erfordernis nach tiefergehendem Wissen und Verständnis für chemische Prozesse nimmt zu.

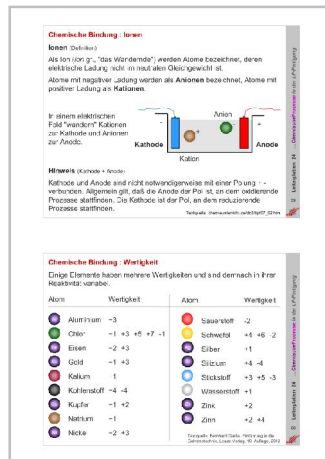


**Leiterplatten 24 ...Chemische Prozesse**

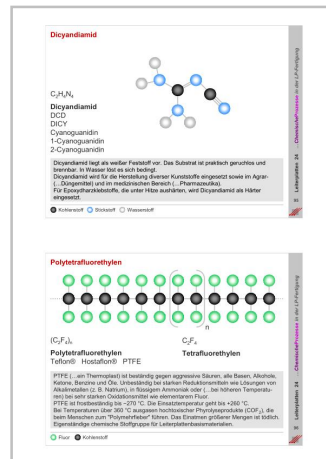
Beispiele für die Inhalte des Seminars.



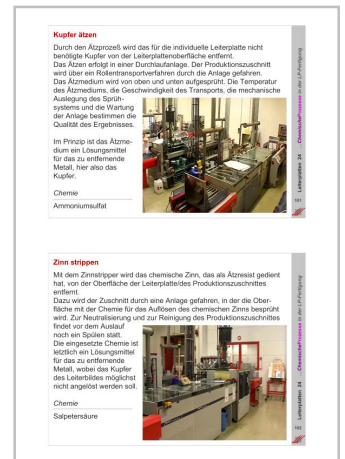
LP24  
*Titelblatt des Seminars*



LP24  
*Ionentransfer und Chemische Bindung*



LP24  
*Chemische Substrate in Basismaterialien*



LP24  
*Chemie in der Leiterplattenproduktion*